# (12)公表特許公報(A)

(19)日本国特許庁(JP)

### (11)公表番号 **特表2023-527634** (P2023-527634A)

(43)公表日 令和5年6月30日(2023.6.30)

(51)国際特許分類		FI			テーマコード(参考)	
G 0 1 N	35/08	(2006.01)	G 0 1 N	35/08	А	2 G 0 4 3
G 0 1 N	21/65	(2006.01)	G 0 1 N	21/65		2G058
G 0 1 N	37/00	(2006.01)	G 0 1 N	37/00	101	

		審査請求	有 予備審査請求 未請求 (全35頁)
(21)出願番号	特願2022-557761(P2022-557761)	(71)出願人	522373965
(86)(22)出願日	令和3年3月18日(2021.3.18)		ストライク フォトニクス , インコーポ
(85)翻訳文提出日	令和4年11月17日(2022.11.17)		レーテッド
(86)国際出願番号	PCT/US2021/022996		アメリカ合衆国 75013 テキサス,
(87)国際公開番号	WO2021/194847		アレン , ミレニアム 600
(87)国際公開日	令和3年9月30日(2021.9.30)	(74)代理人	100094112
(31)優先権主張番号	62/993,033		弁理士 岡部 讓
(32)優先日	令和2年3月22日(2020.3.22)	(74)代理人	100106183
(33)優先権主張国・地	地域又は機関		弁理士 吉澤 弘司
	米国(US)	(74)代理人	100114915
(31)優先権主張番号	63/104,636		弁理士 三村 治彦
(32)優先日	令和2年10月23日(2020.10.23)	(74)代理人	100125139
(33)優先権主張国・地	地域又は機関		弁理士 岡部 洋
	米国(US)	(74)代理人	100209808
(31)優先権主張番号	63/056,580		弁理士 三宅 高志
	最終頁に続く		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 導波管強化分析物検出ストリップを備えたドッキングステーション

(57)【要約】

この開示は、迅速な分析物の検出と報告のために検査カ ードを挿入できるドッキングステーションを提示する。 このドッキングステーションにはポータブル機能があり 、ローカルサーバーまたはクラウドベースのサーバーへ の有線または無線伝送を含めることができる。修正され た導波管を含む検査構造に配置された検査カードをに挿 入し、レーザーと干渉計を含むドッキングステーション を使用すると、検査サンプルを正確かつ迅速に検出でき る。

【選択図】図2



FIG. 2

【特許請求の範囲】

【請求項1】

実装基板と、

第1の基板に形成された最上面および側面を有し、前記実装基板に位置する非クラッド 光導波管センサであって、前記第1の基板は半導体材料を含む、非クラッド光導波管セン サと、

前記非クラッド光導波管センサの前記クラッド部に位置し、または前記クラッド部に隣接するナノ粒子であって、前記ナノ粒子の濃度は、前記最上面の上よりも前記光導波路の前記側面の上、または近傍において高い、ナノ粒子と、

開口部を有し、前記第1の基板に位置するマイクロ流体チャネルであって、分析物が前 10 記開口部に堆積するとき、前記非クラッド光導波路センサに接触する、マイクロ流体チャ ネルと、

前記第1の基板に隣接して位置し、前記非クラッド光導波路に光学的に接続され、前記 実装基板の接続端部まで延在する、光ファイバを有する第2の基板と、を備える検査装置

【請求項2】

前記検査構造は、前記第1の基板内に形成される1または複数の相互接続された金属層であって、前記検査カードの前記1つまたは複数の相互接続された金属レベルに接続された前記1または複数の相互接続された金属層を含む、請求項1に記載の検査装置。 【請求項3】

前記検査構造の前記1または複数の相互接続された金属層は、前記第1基板内に位置して前記光導波路に隣接する駆動電極を含む、請求項2に記載の検査装置。

【請求項4】

前 記 光 導 波 路 セン サ の 出 力 端 部 は 、 テ ー パ さ れ た フ ァ セ ッ ト 面 を 有 す る 、 請 求 項 1 に 記 載 の 検 査 装 置 。

【請求項5】

前記実装基板は、その中に1つまたは複数の金属レベルと前記接続端を有するプリント 回路基板であり、前記1または複数の金属レベルに電気的に接続される表面端子を備え、 前記第1の基板は、前記プリント回路基板の1つまたは複数のレベルに電気的に接続され る1つまたは複数の金属レベルを備え、前記接続端はさらに前記光ファイバに光学的に接 続されるフェルールを備える、請求項1に記載の検査装置。

【請求項6】

前記非クラッド光導波路センサは、前記側面および前記最上面に位置する窒化物層を備える、請求項1に記載の検査装置。

【請求項7】

前記非クラッド光導波路センサは、窒化ケイ素または酸窒化ケイ素を備える、請求項1 に記載の検査装置。

【請求項8】

前 記 光 ファイバは、前 記 第 2 の 基 板 に お け る V 字 溝 に 位 置 す る 、 請 求 項 1 に 記 載 の 検 査 装 置 。

【請求項9】

前記実装ベースの前記接続端は、V字溝光ファイバマウントベースと、フェルールマウ ントベースと、そこから延びる光学フェルールとを備え、前記光学フェルールは前記光フ ァイバに光学的に接続される、請求項8に記載の検査装置。

【請求項10】

第1の基板に形成された最上面および側面を有し、前記検査カード基板に位置する非ク ラッド光導波管センサであって、前記第1の基板は半導体材料を含む、非クラッド光導波 管センサと、

前記非クラッド光導波管センサに位置し、または隣接するナノ粒子であって、前記ナ ノ粒子の濃度は、前記最上面の上よりも、前記非クラッド光導波路センサの前記側面の上

20

40

50

、または近傍において高い、ナノ粒子と、

開口部を有し、前記第1の基板に位置するマイクロ流体チャネルであって、分析物が 前記開口部に堆積するとき、前記非クラッド光導波路センサに接触する、マイクロ流体チャネルと、

前記非クラッド光導波路センサに光学的に接続され、前記検査カード基板の接続端部 まで延在する、光ファイバを有する第2の基板と、

を備える検査カード基板と、

前記検査カードを受け入れるように構成されたドッキングポートを有するハウジングと、

前記ハウジング内に位置し、前記検査構造と光学的に位置合わせされ、そこから伝送 10 を受信するレーザーと、

前 記 八 ウ ジ ン グ 内 に 位 置 し 、 前 記 検 査 構 造 に 光 学 的 に 接 続 可 能 で 、 そ こ か ら 光 伝 送 を 受 信 す る 集 積 ス ペ ク ト ロ メ ー タ と 、

前記ハウジング内に位置するデータプロセッサおよび制御ボードであって、前記制御 ボードは前記レーザーと、干渉計と、前記データプロセッサとを制御するように構成され た前記制御ボードと、

を備える、前記検査カード基板の前記接続端部を受け入れるためのドッキングステーションと、

を備える検査装置。

【請求項11】

前記ドッキングステーションは、電源と、前記ドッキングステーションからのデータの 無線伝送のための通信回路と、をさらに備え、前記通信回路は前記データの無線伝送のた めのアンテナに接続される、請求項10に記載の検査装置。

【請求項12】

前記制御ボードに動作可能に接続される、レーザー駆動装置およびセンサと、DPF駆動装置およびセンサと、干渉計駆動装置およびセンサと、をさらに備える、請求項10に記載の検査装置。

【請求項13】

前記干渉計はマイケルソン干渉計である、請求項10に記載の検査装置。

【請求項14】

前記検査カード基板は、前記第1の基板内に形成される1または複数の相互接続された 金属層であって、前記検査カード基板の前記1つまたは複数の相互接続された金属レベル に接続された前記1または複数の相互接続された金属層を含み、前記検査カード基板の前 記1または複数の相互接続された金属層は、前記第1基板内に位置して前記非クラッド光 導波路センサに隣接する駆動電極を含む、請求項10に記載の検査装置。

【請求項15】

前記非クラッド光導波路センサの出力端部は、テーパされたファセット面を有する、請求項10に記載の検査装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

[関連出願の相互参照]

本出願は、「DOCK STATION WITH WAVEGUIDE ENHANCED ANALYTE DET ECTION STRIP」と題する2020年3月24日に出願された米国特許出願第62/994 ,220号、「ENHANCED WAVEGUIDE WITH MICROFLUIDIC PUMP」と題する2 020年7月25日に出願された米国特許出願第63/056,580号、および「DOCKING STATION AND WAVEGUIDE WITH ENHANCED ANALYTE DETECTION STRIP AND OPTICAL AND ELECTRICAL ALIGNMENT SYSTEM」と題する2020年1 0月23日に提出された米国特許出願第63/104,636号の利益を主張するものであり、 一般に本発明に割り当てられ、参照により本発明に組み込まれている。 30

本発明は、ウイルス、細菌、薬物、または癌細胞などの分析物病原体を含む分析物の迅速な検出または検査のための光学またはフォトデバイスに関する。

(4)

【背景技術】

【 0 0 0 3 】

COVID-19のような新しいウイルスの突然の発症により、感染した可能性のある 個人の迅速な検出が緊急に必要とされている。ごく最近のCOVID-19ウイルスのよ うなパンデミックは、新しく進化する生物学的脅威に対する検査技術の対応に関連する多 くの問題を浮き彫りにしている。現在の検査技術は、現在の供給不足に直面しているだけ でなく、結果を迅速に取得し報告する手段も提供していない。例えば、現在の検査技術で は、ウイルスの存在を確認するのに数日かかる。さらに、対象者が十分な時間感染してい ない場合、検査は偽陰性を示し、それによって知らず知らずのうちに一般住民への曝露を 引き起こす可能性がある。現在の検査技術には、変異を迅速に同定し追跡する能力も欠け ている。さらに、報告時間の遅れは、政府当局が適切な政策を形成し実施する上で重要と なりうる最新のデータを欠く原因となる。

【0004】

したがって、この技術において緊急に必要とされるのは、感染の可能性のある対象者に おける病原体の存在を正確かつ迅速に決定し報告することができる迅速な応答試験技術で ある。

[0005]

上記で議論された先行技術の欠陥に対処するために、本開示は、ウイルスまたは細菌の ようなヒト病原体、ならびに薬物、その他の化学物質、または癌細胞を含む分析物の検出 において、直接的、迅速かつ感度を高めた正確な測定および検出を提供する、独自の光学 ベースの検出技術を提供する。COVID-19ウイルスが広がり続ける中、この技術は 、現在のバイオアッセイの許容できないほど低い感度レベルと誤った結果とのギャップを 埋めるために不可欠であり、単一のプラットフォームでより広範な感染性病原体をより迅 速かつ高感度に検出する必要性が高まっている。

[0006]

ここに示す実施形態は、マイクロ流体および積層製造法によるフォトニック処理ソリュ ーションを提供し、迅速なウイルス検出、同定、および報告ソリューションを提供するた めのコンパクトで表面増強ラマン分光法(SERS:Surface‐Enhanced Raman Spectroscopy)ベースのシステムを実装する。これらの実施形 態は、任意の医療施設、公衆衛生、および第一対応者ユニットへの展開を可能にするデバ イス取得コストで、特定の病原体の存在についての非常に正確でほぼリアルタイムのスク リーニングと報告を提供する。SERS相互作用からのラマンスペクトルをマイケルソン 干渉計と結合した検出器を用いて検出する。ここに開示された実施形態は、感染のリアル タイム遠隔検出および監視;感染性病原体、汚染された体液への人員の曝露または輸送を 制限する、制御され隔離されたテストプロトコルの迅速な同時同定;検査対象から隔離さ れた人員への検査ストリップからのデータの無線伝送;ほぼ瞬時の検査結果;エージング アウトする試薬や試料の二次加工を必要としない検査の実施;低コストで、製造が容易で 、迅速に展開でき、最小限の訓練で操作される検査要素;および、ウイルス検出以外の拡 張された用途を提供する。

[0007]

この開示の実施形態には、迅速な分析物の検出と報告のために検査カードを挿入できる ドッキングステーションが含まれる。このドッキングステーションにはポータブル機能も あり、ローカルサーバーまたはクラウドベースのサーバーへの有線または無線伝送を含め ることができる。

上記は、当業者が以下の詳細な説明をよりよく理解できるように特徴を概説したもので ある。クレームの主題を形成することができる追加の特徴を以下に説明する。当業者は、

10

20

JP 2023-527634 A 2023.6.30

開示された概念および特定の例を、ここに開示されたのと同じ目的を遂行するために他の 構造を設計または修正するための基礎として容易に使用できることを認識すべきである。 当業者はまた、そのような同等の構成が開示の精神と範囲から逸脱していないことを認識 すべきである。 本発明をより完全に理解するために、添付の図面と併せて以下の説明を参照する。 【図面の簡単な説明】  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 【図1A】検査カードを備えるドッキングステーションの一実施形態を示す。 【図1B】ドッキングステーションに挿入するように構成された検査カードの一実施形態 の上面図を示す。 【図1C】図1Bの検査カードの部分的な断面図を示す。 【図1D】ドッキングステーションに挿入するように構成された検査カードの別の実施形 態の斜視図を示す。 【図1E】ドッキングステーションの光学回路との光学的位置合わせを実現し、検査カー ドとドッキングステーションとの間の電気的接続を実現するためにドッキングステーショ ンに挿入された検査カードの別の実施形態の上面図を示す。 【図1F】ドッキングステーションに接続されるように構成されたフレキシブル延長サン プリングストリップの斜視図を示す。 【図2】ドッキングステーションに実装できる検査カードのマイクロ流体チャネルの導波 管の部分的な断面図を示す。 【図3A】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3B】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3C】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3D】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3E】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3F】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3G】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図3H】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態から生じる中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【 図 3 I 】 検 査 構 造 の 導 波 管 を 製 造 す る た め に 使 用 さ れ る プ ロ セ ス 実 施 形 態 か ら 生 じ る 中 間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4A】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4B】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4C】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4D】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4E】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4F】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。

(5)

30

40

20

10

10

20

(6)

【図4G】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ

る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図4日】マイクロ流体チャネルを製造するために使用されるプロセス実施形態から生じ る中間デバイスの部分的な断面図を示す。 【図5A】検査構造のマイクロ流体チャネルに接続されたマイクロ流体ポンプの異なる実 施形態のレイアウト図を示す。 【図5B】検査構造のマイクロ流体チャネルに接続されたマイクロ流体ポンプの異なる実 施形態のレイアウト図を示す。 【図6A】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態のフローチャ ートを示す。 【図6B】検査構造の導波管を製造するために使用されるプロセス実施形態のフローチャ ートを示す。 【図7】マイクロ流体チャネルを作成するために使用されるプロセス実施形態のフローチ ャートを示す。 【図8】検査カードと構造およびドッキングステーションの一実施形態のブロック図の一 実施形態を示す。 【図9】ドッキングステーションの一実施形態内の異なる構成要素を示すブロック図の一 実施形態を示す。 【図10】干渉計と安定化光源の一実施形態のレイアウトを示す。 【発明を実施するための形態】 [0010]

ヒトウイルスのリアルタイム検出と特性評価、およびその他の生化学的および非生化学 的分析を提供するシステムが非常に必要とされている。現在、コロナウイルス、COVI D-19のような病原体は、長いサイクルの潜伏、初期の無症候性感染、空気感染、およ びその高い感染性の性質が組み合わさって、封じ込めに成功しないまま広まっている。単 純で迅速かつ効率的な検査検出能力が欠如しているため、感染者は早期に隔離から移行し たり、症状が出るまで完全に隔離を逃したりする可能性がある。本開示において提示され る様々な実施形態は、これらの現在の緊急のニーズに対処するものである。

図1Aは、上記のニーズに対処する検査装置100の一実施形態の斜視図である。例示 30 された実施形態は、ドッキングステーション105と、ドッキングステーション内で受信 されるように構成された検査カード110を含む。検査構造115は、検査カード110 に配置され、接続される。以下に説明するように、検査構造115は、検査される流体ま た は 分析物の 流体 経 路 を 提 供 す る マ イ ク ロ 流 体 チ ャ ネ ル を 有 す る 。 検 査 構 造 115 は 、 以 下に説明するように、その中に形成された修正された導波管を有する。光導波管は、導電 性ナノ粒子またはそれに関連したナノ構造で修正されるが、これについても後述する。検 査サンプルまたは分析物が検査構造115に適用された後、検査サンプルを含む検査カー ド110がドッキングステーション105に挿入される。ここでの実施形態は、以下でよ り詳細に説明するように、検査構造115の光学回路、検査カード110の電子回路、お よびドッキングステーション105の光学および電気回路が、検査カード110、検査構 40 造、およびドッキングステーション105の間の光学および電気パスを形成するように整 合させる光学的および電気的位置合わせ(alignment)システムを提供する。検査カー ド110とドッキングステーション105との連携により、分析物のほぼ瞬時かつ正確な 検査結果が得られる。

【0012】

検査カード110/検査構造115とドッキングステーション105との間の光学および電気回路の適切な機械的位置合わせは、いくつかの方法で達成することができる。例えば、ある実施形態では、図1Bおよび図1Bの一般的な断面図である図1Cに見られるように、検査カード110はプリント基板(PCB)であり、PCBの層間に形成された1つ以上の金属レベル110aを含む。図1Cに概略的に示すように、1つ以上の金属レベ

10

40

ル110aは、検査構造115の1つ以上の金属レベル115aに電気的に接続されている。既知のプロセスを使用して設計および製造することができる1つ以上の金属レベル1 10a、115aは、検査カード110のインターフェース端110cで検査構造115 を表面電気接点110bに電気的に接続する。この実施形態は、検査流体をその中で受け 取ることができる流体入力ポート115bを備えた検査構造115を含む。前述のように 、表面接点110bは、検査カード110がドッキングステーション105に挿入された ときに、検査カード110とドッキングステーション105との間の電気的接続を提供す る。さらに、一実施形態では、検査構造115は、検査構造115の基板に形成されたV 字型の溝に配置することができる光ファイバー115dを含む光インターフェース端部1 15cを含む。光ファイバ115dは、検査構造115とドッキングステーション105 内の光学部品との間の光接続を提供し、電気表面接点110bは、検査カード110とド ッキングステーション105との間の電気接続を提供する。

図1 Dは、検査カード1 1 0 および検査構造1 1 5 の別の実施形態の斜視図を示している。この実施形態では、検査カード1 1 0 は、検査カード1 1 0 がドッキングステーション1 0 5 に適切に挿入されたときに、ドッキングステーション1 0 5 の電気回路(図1 A)への電気接続を提供する電気リード接点1 1 0 bを含む。特定の実施形態では、静電短絡の発生を防ぐために、電気リード接点1 1 0 bに接地リード1 1 0 b(2)を含めることができる。

検査構造115は、光フェルール(ferrule)マウントベース1100eがマウントされ 20 たV字型の溝型のファイバマウントベース1100はまで延びる2つのV字型の溝型の光フ ァイバ1150(dual V-Groove optical fibers)を含む。光フェルールマウントベ ース1100eは、間隔を空けて配置され、検査構造115の光ファイバ1150に光学的 に接続された光フェルール110fを含む。光ファイバ1150とフェルール110fは 2つしか示されていないが、他の実施形態では示されている数以上の光ファイバと光フェ ルールを含むことができる。この図には示されていないが、検査カード115内の前述の 金属層は、検査構造115から電気リード接点1100bまで延在し、検査カード110と 図1Aのドッキングステーション105との間の電気的接続を提供する。検査カード11 0をドッキングステーション105の光学および電気回路に位置合わせされる 30 か、接続される。

[0014]

上記で説明した実施形態では、既知のリフロープロセスを使用して検査ストリップ11 5を検査カード110に取り付け、検査カード110の金属層110aを検査ストリップ 115の金属層115aと電気的に接触させることができる。 【0015】

図1 E は、図1 A のドッキングステーション105が、検査構造115の2つのV字型 の溝型の光ファイバ115 b を、光導波管105 b およびドッキングステーション105 の電気回路(図示せず)と適切な光学的および電気的位置合わせに保持するために使用さ れる、スプリングバイアスクリップ装置105 a を含む一実施形態の部分的な上面図を示 している。この実施形態では、検査カード110上に検査構造115を高精度に配置して 位置合わせの複雑さを軽減し、×軸と z 軸の導波管端の位置精度を5ミクロン未満にする ことができる。スプリングバイアスクリップ装置105 a は、検査構造115と検査カー ド110の端をドッキングステーション105との光学的および電気的接続に導くだけで なく、一度接続が行われると、ドッキングステーション110に対して相対的に検査カー ド110を保持する。さらに別の実施形態では、導波管位置合わせの正確な基準を提供す るために、滑らかな表面と既知の厚さを実現するために、検査カードにアルミナを使用す ることができる。

[0016]

前述のように、検査構造115には流体サンプルまたは入力ポート115aがある。し 50

かしながら、場合によっては、サンプルを提供する者を検査を実施する者からさらに隔離 することが望ましい場合もある。このような場合には、拡張検査ストリップ構成を利用す ることができる。図1Fは、検査構造115がフレキシブルストリップ120a内に配置 された光学的および電気的経路(図示せず)を持つフレキシブルサンプリングアダプタ1 20に接続可能な一実施形態を示している。フレキシブル基板120の一端には、対応す る光学 V 溝115 b と、検査構造115に接続する電気接点があり、反対側の端には、 V 字型の溝120 b と、検査カード110に接続する電気接点があり、これらは、上述の実 施形態を介してドッキングステーションに挿入することができる。距離規制が必要な場合 、フレキシブルサンプリングアダプタ120は、検査サンプルを収集する際により多くの 距離の分離を可能にする。

【0017】

操作の一実施形態では、ドッキングステーション105内のフォトニック測定インフラストラクチャと検査カード110上の検査構造115との間の光学的位置合わせを確保するためのキャリブレーションサイクルが行われるドッキングステーション105に検査カード110が配置される。このキャリブレーションが完了すると、緑色のLED、またはその他のキューによって、検査カード110のサンプルの準備ができていることが示される。分析物の単一液滴を流体入力またはサンプルポート115aに置く。必要なサンプル体積は0.1nLから10nLの間である。検査構造115のマイクロ流体チャネル内の伝搬は、チャネル内の抵抗変化によって測定される。サンプルを検出した後、目標長を伝播するとして、誘電泳動(dielectrophoretic)のサイクルを可変周波数で行い、ラマンスペクトル測定を行うことで、上記のように必要に応じて過剰な生体分子干渉を差し引く機構を提供することで、最高レベルの精度を確保する。

【0018】

図 2 は、図 1 に一般的に示されているように、検査カード 1 1 0 の検査構造 1 1 5 の一 実施形態の部分的な断面図を示す。この実施形態では、検査構造115は半導体基板21 0 上に配置された導波管205を含む。基板210は、シリコン基板上の二酸化シリコン を備え、二酸化シリコン層内に形成された1つ以上の相互接続された金属レベル210a 210 bを含む。既知のリソグラフィおよび蒸着プロセスを使用して、検査構造115 を作成することができる。一実施形態では、半導体基板210内の金属レベル210a、 2 1 0 b の 1 つは、 導 波 管 2 0 5 に 垂 直 な 電 磁 場 を 形 成 す る た め に 使 用 で き る 誘 電 体 泳 動 ポンプを形成するために使用できる2つの電極の1つであるバッキング電極215を含み 得る。ただし、他の実施形態では、駆動電極215はオプションであり、したがって、存 在しない場合もある。<br />
一実施形態では、<br />
導波管205はSiN2、Si3N3、SiON などの窒化シリコン材料を含み、既知のリソグラフィおよび蒸着プロセスを使用して蒸着 およびエッチングすることができる。窒化シリコンを例として挙げたが、ヒ化ガリウム、 ヒ化アルミニウムガリウム、シリコン、酸化アルミニウム、オキシ窒化シリコン、ドープ 二酸化シリコン(チタン、リチウム、リン、ホウ素など)、またはそれらの組み合わせな どの他のタイプの導波管を使用してもよく、これらも本開示の範囲内である。基板210 、金属レベル210a、210b、および導波管205は、以下で説明する他の要素とと もに、独自の光学検査回路を形成する。

【0019】

銀、金、銅、白金、パラジウム、アルミニウム、またはそれらの組み合わせなどのナノ 粒子220は、導波管205上または(本明細書および特許請求の範囲で使用される「ま たは」は、連言形(conjunctive)および選言形(disjunctive)「および/または」 を含む)隣接して位置する。つまり、ナノ粒子は、導波管205によって伝送される光信 号の電荷移動、またはプラズモン共鳴を形成するのに十分に近い。一実施形態では、ナノ 粒子220の濃度は、外面205bよりも導波管205の側面205aにおいて、または 隣接する側面の方が高くてもよい。本明細書および特許請求の範囲において、「外面(o uter surface)」とは、マイクロ流体チャネル230の深さまで最も長く延びる表面で ある。ナノ粒子220は、導波管205の長さのセンサ部分に沿って延びている。センサ 10

20



部 分 は 、 検 査 デ ー タ が 収 集 さ れ 、 検 査 結 果 を 決 定 す る た め に 使 用 さ れ る 導 波 管 2 0 5 の 部 分である。センサ部分は、導波管205の長さを延長することも、その一部のみを延長す ることもできる。一実施形態では、導波管205にはクラッド部と非クラッド部があり、 非クラッド部は導波管205のセンサ部である。このような実施形態では、ナノ粒子は非 クラッド部に配置されるが、他の実施形態では、導波管205がクラッドされ、ナノ粒子 が導波管205のクラッド上に堆積される場合がある。このような実施形態では、ナノ粒 子は非クラッド部に配置されるが、他の実施形態では、導波管205の長さはクラッドさ れていてもよく、ナノ粒子は導波管205のセンシング長に沿ってクラッド上に堆積され てもよい。

[0020]

ナノ粒子220は、検査流体または分析物に関連するデータ収集を改善する。具体的に は金属が挙げられるが、ナノスケールで蒸着や形成が可能な他の導電性の高い材料を使用 することもできる。例えば、ナノ構造の半導体表面を使用して電荷移動、またはプラズモ ン共鳴を形成することもできる。使用が検討されている半導体材料には、炭化ケイ素、炭 素、窒化ガリウムなどの狭いバンドギャップ材料のほか、ゲルマニウム、セレン化鉛、テ ルル化鉛、アンチモン化ガリウム、ヒ化ガリウム、リン化インジウムなどの狭いバンドギ ャップ材料がある。さらに、カルコジナイドモリブデンジスルフィド(MoS2)のよう に、ナノ構造の挙動が独自の利点を持つ可能性のあるいくつかの進化中の半導体もある。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 

20 | 半 導 体 基 板 2 1 0 の 導 波 管 2 0 5 が あ る 側 に 、 第 2 の シ リ コ ン 基 板 2 2 5 が 接 合 さ れ て いる。第2シリコン基板225にはマイクロ流体チャネル230が形成される。マイクロ 流体チャネル230は、一般的に示されているように、導波管205の側面205aと最 外 面 2 0 5 b が マイ ク ロ 流 体 チ ャ ネ ル 2 3 0 内 に 延 び る よ う に 、 導 波 管 2 0 5 を カ プ セ ル 化する。マイクロ流体チャネル230は、検査流体または分析物が配置されるチャネルを 提供する。

バッキング電極215が存在するこれらの実施形態では、第2の基板225は駆動電極 235を含む。電極215と235を使用して、病原体などの対象の分子のナノ構造表面 への制御された遷移を促進するための追加の電場を生成することができる。図の実施形態 で見られるように、一般的に示されるように、バッキング電極215はシリコン基板21 0内に位置し、導波管205に隣接し、駆動電極235はシリコン基板225上に位置し マイクロ流体キャビティ230内にある。駆動電極235は、別の実施形態で示されて いるように金属ストリップであってもよいし、n型基板またはシリコン表面を大量に注入 して形成してもよい。電極215および235を使用して、マイクロ流体チャネル230 内で誘電泳動(DEP)力を発生させるための高周波(3-5MHz)電圧を電極に印加 し、対象の分析物を測定表面に駆動することができる。  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 

D E P は、特定の質量とサイズの生体分子を、エバネッセント誘導プローブビームと相 互作用する対象分析物の量を劇的に高めることができる測定表面に駆動するために使用さ れる。DEP力は、導電性粒子と非導電性粒子の両方に加えることができ、直流(DC) または交流(AC)の場を使用することによって発生させることができる。誘電泳動力に よって、ウイルスを非常に正確に分類することができる。DEP力は不均一な電場の存在 下で懸濁粒子(浮遊粒子)に働く力である。力の大きさと方向は、電場強度、粒子半径、 粒子と懸濁液との誘電率、および粒子と懸濁液との伝導率に関連している。DEPは、制 御可能であり選択的かつ正確な対象ウイルスの操作を提供する。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ 

知られているように、DEPは生体分子の双極子と電場の空間勾配との相互作用による 不均一な電場での粒子の動きである。生体分子の双極子は、主に2つの現象に由来する。 1)原子の配向(orientation)と配置(configuration)による永久双極子、2)粒 子表面に電荷の再分布をもたらす外部電場の印加によって生じる誘起双極子。

10



[0025]

生体分子の挙動は、物質が界面で電荷を生成する能力の尺度である分極率によって記述 することができる。その分極率は、物質が電場に応答する能力の尺度であり、(i)電子 分極、(ii)原子分極、(iii)配向分極という3つの基本的なメカニズムがある。 【0026】

10 k H z から100 M H z の動作周波数内の粒子に誘起された双極子の起源であるため、界面分極率は制限される。粒子の分極率が媒質の分極率より高い場合、粒子の側により多くの電荷が蓄積する。媒質の分極率が粒子の分極率よりも高い場合、媒質側により多くの電荷が蓄積する。この電荷の不均一な分布は、粒子の両側の電荷密度の違いを意味し、これにより、印加された電場と整列した粒子全体に誘起された双極子が生じる。粒子-媒質系が不均一な電場に置かれると、粒子は両端で異なる力を感じる。両端の力の差は、 粒子と媒質の分極率に応じてどちらの方向にも正味の力を発生させる。 【0027】

交流誘電泳動AC-DEPを適用するための一般的な方法は、マイクロチャネルネット ワーク内に埋め込まれた金属電極のアレイである。ほとんどの場合、これらの内部電極は 平面(2-D)電極(すなわち、電極の高さは100ナノメートルのオーダーである)で あり、デバイス内に製造される。AC-DEPは、ジュール発熱を防ぐ低い動作電圧によ り有利である。さらに、低い印加電圧は電界を発生させるために必要な回路を簡素化し、 AC-DEPフォーカシングシステムを集積回路と互換性があり、バッテリー駆動のハン ドヘルドデバイスに適したものにする。

【0028】

このように、DEPはウイルス検出技術を強化し、測定表面に沈着した選択的ウイルス 分析物の量を強化し(enhancing)または高め(enriching)る。代替として、他の実 施形態では、同じ検査構造内の多数の分析物の選択的、同時的、特性化および同定を可能 にするために、生体分子をサイズおよび構造によって分離する周波数可変および位相選択 的な誘電泳動を採用することができる。

【0029】

図3A - 3Iは、検査構造115の複数の導波管205を製造するために使用できるプロセスの一実施形態の中間構造300の部分的な断面図を示す。図3Aは、二酸化シリコン層310を成長させたシリコン基板305を示す。また、窒化シリコン層315と、窒化シリコン層315上に位置するパターン化されたフォトレジスト層320も見られる。 既知のプロセスおよび材料を使用して、この図示された中間構造および後述の中間構造を 形成することができる。シリコン基板305は、P型ドーパントをドープした200mm のシリコンウェハであってもよく、実施形態によっては、ドーパント濃度と厚さが変わり 得る。一実施形態では、二酸化シリコン層310は2000nmの厚さに形成することが できる。後にパターン化されて導波管を形成する窒化シリコン315層の厚さも変わり得 る。特定の実施形態では、厚さは約100nmから約200nmの範囲であり得る。一実 施形態では、ドライエッチングを使用して窒化シリコン層315のマスクされていない部 分をエッチングし、設計要件に応じて異なる間隔を持つ導波管を生成することができる。 例えば、ある実施形態では、エッチングされた導波管の間隔は約300nmであり得る。

図3Bは、図3Aに示すデバイスの中間的な実施形態を示しており、窒化シリコン31 5のパターン化に続いて複数の導波管315aを形成している。一実施形態では、既知の ドライエッチングを用いて導波管315aを形成してもよい。導波管315aの1つの拡 大図315bに示されているように、ドライエッチングにより、導波管の端部が約0°か ら約4°にテーパすることがある。導波管315aのテーパした端部は、電荷移動または プラズモン共鳴をさらに形作るのに役立つ。ドライエッチングに続いて、ストリップレジ ストやウェハクリーンプロセスなどの既知のプロセスを使用して、残りのフォトレジスト 320を導波管315aから除去する。いくつかの実施形態では、導波管315aは、そ の長さを長くするために様々な蛇行形状設計にパターン化することができる。例えば、図 10

20

30

50

3 C は、 導 波 管 3 1 5 a が 長 方 形 の 折 り 畳 み 構 成 ま た は 蛇 行 形 状 3 1 5 c 、 ま た は 円 形 構 成315dでパターン化されるいくつかの例を示している。これらはいくつかの例として のみ提示され、他の幾何学的デザインも本開示の範囲内である。さらに、フォトレジスト のパターン化中に、同じレチクルを使用して、エッチングされたファセット(facet)表 面330の近くにテーパ領域325(図3Dに見られるように)を形成することができる この狭められたテーパ領域325は、導波管の出力端付近のモードおよび光伝送を改善 する。一実施形態では、図3Dに見られるように、窒化シリコン導波管315の端部に光 学ファセット表面を規定するためにディープエッチングを行うことができる。このオプシ ョンのエッチングは、下にあるシリコン酸化物を貫通し、さらに2~3ミクロンのシリコ ンの中にまでエッチングするように実施される。このような実施形態では、滑らかな酸化 物表面を得るためにウェットクリーンのフォローが必要となる場合がある。 [0031]

図3Eは、残りのフォトレジスト320を除去し、その後のウェットエッチングプロセ スのためのエッチング制御を提供する窒化物エッチストップ335を蒸着した後の図3B のデバイスを示している。窒化物エッチストップ335を堆積させるために既知の堆積プ ロセスを使用することができ、約20 nmから約30 nmの範囲の厚さまで堆積させるこ とができる。窒化物エッチストップ335は、以下に示すように、導波管のセンサ部分を 露出させるために使用されるウェットエッチングのエッチング制御を提供する。 ー 実 施 形 態 で は 、 こ の 窒 化 物 エ ッ チ ス ト ッ プ 3 3 5 は 導 波 管 上 に 残 り 、 導 波 管 の 伝 送 容 量 を拡大する役割を果たす。窒化物エッチストップ335は、以下に示すように、導波管の センサ部分を露出させるために使用されるウェットエッチングのエッチング制御を提供す る。 - 実施形態では、窒化物エッチストップ335は導波管315a上に残り、導波管伝 送容量を拡大する役割を果たし、分析物からのデータ収集をさらに強化する。 

図 3 F は、既知の堆積プロセスを使用した、酸化シリコン層 3 4 0 の堆積後の図 3 E の 中間デバイスを示している。二酸化シリコン層340の厚さは様々であるが、一実施形態 では厚さは約2ミクロンであり得る。また、酸化シリコン層340は、後述するように導 波管315aの少なくとも一部に対してクラッド層として機能する。 [0033]

図3Gは、フォトレジスト345にセンサ開口部350を形成するためにフォトレジス ト345を蒸着し、パターン化した後の図3Fの中間デバイスを示している。センサ開口 部350は、導波管の一部から酸化ケイ素を除去する後続のエッチングのために酸化シリ コン340の領域を露出させ、その結果、ナノ粒子が堆積され、対象の分析物からデータ を収集するために使用されるクラッドされていない導波管315aが生じる。次に、既知 の基本的なウェット酸化物エッチングを行って、ターゲット導波管上のシリコン酸化物ク ラッドを除去すると、図3日に示すように中間構造が得られる。図3日に示すように、導 波管315aの一部は二酸化シリコン340によってクラッドされたままであり、他の部 分はクラッドされておらず、対象の分析物からデータを収集するためのセンサとして機能 する。これらの非クラッド部分は、対象の分析物に関するデータを収集するために使用さ れるセンサ領域として機能する。 40

図 3 I は、図 3 H に 見 ら れ る よ う に 、 露 出 し た 導 波 管 3 1 5 a 上 に ナ ノ 構 造 3 4 5 が 形 成された後の中間構造を示している。いくつかの実施形態では、ナノ構造345は、約1 4 0 n m から 3 0 0 n m ピッチで約 7 0 n m から約 1 0 0 n m の範囲の直径を持つことが できる。ただし、デバイスのパフォーマンスを最適化するために、他の範囲やピッチを使 用することもできる。ナノ構造を形成するために異なる堆積プロセスを使用することがで きる。例えば、一実施形態では、ナノ構造345は、インクジェット堆積プロセスを使用 して堆積させることができる。別の実施形態では、ナノ構造345は、深紫外線(DUV )フォトリソグラフィまたは金属蒸着リフトオフを伴う電子ビームリソグラフィを使用し て、用いられることができる。このような実施形態では、リフトオフ構造の厚さは、平均

50

20

直径に応じて、約40nmから約80nmの範囲である。 【0035】

図4A-4Hは、導波管205が形成されるウエハに最終的に接合されるウエハ内に上記のマイクロ流体チャネル230を製造するプロセスフローの一実施形態の中間構造400の部分的な断面図を示している。マイクロ流体チャネル230は、接合されると、図2に示すように、導波管の側面と最外面の周りに密閉された流体チャネルを形成する。一実施形態では、マイクロ流体チャネル230は、以下で説明するように、浅いエッチング構造と深いエッチング構造の二つのレベルから構成される。浅いエッチは横方向の毛細管流を支持し、深いエッチ構造はポスト裏面研削中に露出する通気口と供給口を提供する。

(12)

図4Aは、一実施形態では、既知のP型ドーパントがドープされた200mmのシリコ ンウエハであり得るウエハ405を示し、その濃度と拡散深度は最適化された設計要件に よって異なり得る。酸化成長や堆積プロセスなどの既知のプロセスを使用してシリコンウ エハ405上にパッド酸化物410を形成する。酸化シリコン層410の厚さは波打つこ とがある。例えば、ウェットエッチング条件では、厚さは約100nmまたは30nmか ら50nmであり得る。窒化シリコン層415は酸化物層4100上に配置され、特定の 実施形態では、その厚さは約300nmであり得る。窒化シリコン層415は浅いトレン チェッチングのハードマスクの特徴である。酸化物層410は、その後のステップで窒化 ケイ素415層の孤立除去を提供する。

【 0 0 3 7 】

図4Bは、パターン化されたフォトレジスト420をもたらす既知のフォトレジスト堆 積、現像、およびストリッププロセスに続く図4Aの中間デバイスを示している。パター ン化されたフォトレジスト420は、その後にエッチングされる中間デバイスのトレンチ 領域425を露出する。

【0038】

図4 C は、浅いトレンチ430を形成するウェットまたはドライエッチングのいずれか である既知のハードマスクエッチングプロセスに続く図4Bの中間デバイスを示している 。エッチングの深さは様々であるが、特定の実施形態では、エッチングの深さは3から6 ミクロンであり得る。見られるように、エッチは酸化層410と窒化シリコン層415の 一部をアンダーカットする。パターン化されたフォトレジスト420は、示されているが 、エッチングを行う前に除去することができる。エッチング後、窒化シリコン層415お よび酸化物層410は既知のストリップおよびクリーニングプロセスを用いて除去され、 図4Dの中間デバイスが得られる。

[0039]

図4 E は、より深いトレンチを形成するために使用される浅いトレンチ430内のフォ トレジスト層435の堆積とパターン形成に続く図4Dの中間デバイスを示している。一 実施形態では、BOSCHエッチングプロセスのような深い反応性イオンエッチングプロ セスを使用して、深いトレンチ440を約200ミクロンの深さまでエッチングし、図4 Fに示す中間構造を得ることができる。エッチングに続いて、既知のストリップレジスト アッシュ処理が行われ、クリーンプロセスによって流れ、浅いトレンチ430と深いトレ ンチ440を含む図4Gに示す中間構造が得られる。 【0040】

図4Hは、フォトレジストを除去して酸化物層445を形成した後の図4Gの中間デバ イスを示しており、一実施形態では、約75nmから約100nmの厚さまで成長させる ことができるが、デバイス性能を最適化するために他の厚さを使用することもできる。前 述のように、駆動電極が存在するこれらの実施形態では、トレンチの底に電極を堆積させ たり、深いトレンチ440の底の露出したシリコンに高伝導領域を形成するためにインプ ラントを行うことができる。

[0041]

図4日に示す中間構造のクリーニングに続いて、浅いトレンチ430と深いトレンチ4 50

30

40

30が形成されたシリコンウエハ 405を反転してフォトニック基板に接合し、図2に示す一般的な構造となる。

[ 0 0 4 2 ]

一実施形態では、マイクロ流体チャネル230をマイクロ流体ポンプ500、505に 流体的に接続してもよく、これは単なる2つの例示的な実施形態である。図5A-5Bは いくつかの実施形態の例を示しているが、マイクロ流体ポンプ500、505は、図5A および図5Bに一般的に示されているように、任意の数の蛇行形状として設計することが できる。図 5 A - 5 B に見られるように、強化 / 修正された導波管 5 1 0 、 5 1 5 および それらに関連するマイクロ流体チャネル520、525とマイクロ流体ポンプ530、5 35は、特定の用途のためにそれぞれの導波管510、515の長さを最適化するために 使用できるいくつかの幾何学的構成を持つことができる。しかしながら、設計パラメータ に応じて、いくつかの実施形態では、マイクロ流体チャネル520、525は関連するマ イクロ流体ポンプを持たない場合がある。例えば、設計パラメータがそのように要求する 場合、強化 / 修正導波管 5 1 0 、 5 1 5 とマイクロ流体チャネル 5 2 0 、 5 2 5 の長さは 、マイクロ流体ポンプを必要としないように十分に短くすることができる。設計パラメー タが必要な他の実施形態では、強化/修正された導波管510、515と関連するマイク 口流体チャネル520、525は、それぞれ、図5A-5Bに見られるように、より長い か、より複雑である。このような実施形態では、マイクロ流体ポンプ530、535が存 在し、分析物は、流体入力ポート540、545を介してマイクロ流体チャネル520、 525に導入される。マイクロ流体ポンプ530、535は、存在する場合、毛細管原理 で動作し、マイクロ流体チャネルを通って導波管を越えて流体を引き込むのを助け、テス トサンプルから最大のデータを得ることができる。しかしながら、他の実施形態では、マ イクロ流体ポンプ530、535を機械的に駆動して、マイクロ流体チャネルを通して検 査流体をポンプすることもできる。例えば、マイクロ流体ポンプは圧電材料を含んでもよ く、マイクロ流体チャネルを通して検査流体を移動させることができる。マイクロ流体チ ャネル530、535の長さと幾何学的構成は変化してもよく、設計パラメータとシステ ム要件に依存する。図示された実施形態では、マイクロ流体チャネル520、525およ びマイクロ流体ポンプ530、535は一般的な蛇行形状を有するが、先に述べたように 、 他 の 幾 何 学 的 形 状 は 本 開 示 の 範 囲 内 で あ る 。 既 知 の リ ソ グ ラ フ ィ プ ロ セ ス お よ び 材 料 を 使用して、マイクロ流体チャネルを作成することができる。 [0043]

図6A-6Bは、上記のように、検査構造の異なる実施形態を作成するために使用でき る異なるプロセスフローの例を示す。フローチャートは一般的な性質であり、特に明記さ れていない他の既知の中間ステップも実施することができるため、これらの実施形態の範 囲内にある。図6Aの実施形態では、ステップ1は、サードパーティのサプライヤから、 またはメーカー内部の供給元からシリコン基板を提供することから始まる。ステップ2で は、クラッド下酸化物を約2ミクロンの厚さに形成する。ステップ3では、窒化シリコン 導波材を蒸着する。一実施形態では、最小導波管の幅は約300nmである。ステップ4 では、フォトレジストとリソグラフィプロセスを使用して窒化シリコン導波材をパターン 化し、エッチングして複数の導波管を形成する。ステップ5では、特定の実施形態では任 意であるが、パターン化された導波管上に窒化シリコンのエッチストップ層が堆積される 。任意のステップA)において、光学ファセットの選択的なクリア/エッチングが、導波 管の端の光学ファセットを形成してもよい。ステップ6では、エッチングされた導波管の 上に酸化物の上部クラッドが堆積される。一実施形態では、上部クラッド酸化物は約2ミ クロンの厚さを有する。ステップ7では、上部クラッド酸化物をフォトレジストでパター ン化し、センサー導波管を露出させる。ステップ8では、選択した導波管領域を露出する ために酸化物エッチングを行い、他の導波管長はクラッド酸化物で覆われたままにする。 ファセットエッチングのための任意のパターンは、下にある酸化物を介してシリコン基板 に伝導され、その後、さらなる平滑化のために任意のファセット湿式プロセスを行うこと ができる。ステップE1では、例えば銀ナノ粒子のインクジェット蒸着を使用して、露光

10

20



された導波管にそれらを蒸着する。一実施形態では、インクジェット蒸着は、外部プロセ スとして、接着剤材料と一緒に行うことができる。 [0044]

図6Bの代替的な実施形態のプロセスフローでは、ステップ1は、サードパーティのサ プライヤまたはメーカー内部の供給元からシリコン基板を提供することから始まる。ステ ップ2では、下部クラッド酸化物を約2ミクロンの厚さに形成する。ステップ3では、窒 化シリコン導波材を蒸着する。一実施形態では、最小導波管幅は約300nmである。ス テップ4では、フォトレジストとリソグラフィプロセスを使用して導波管をパターン化お よびエッチングし、複数の導波管を形成する。任意のステップであるステップ5では、い くつかの実施形態において、パターン化された導波管上に窒化シリコンのエッチストップ 層が堆積される。任意のステップA)では、光導波管の終端で光ファセットの選択的なク リア/エッチングを行うことができる。ステップ6では、パターン化された窒化物導波管 の上に酸化物の上部クラッドが堆積される。一実施形態では、上部クラッド酸化物は約2 ミクロンの厚さを有する。ステップ7では、センサ導波管の上にフォトレジストで上部ク ラッド酸化物をパターン化する。ステップ8では、選択した導波管領域を露出するために 酸化物エッチングを行い、他の導波管長はクラッド酸化物で覆われたままにする。ファセ ットエッチングのための任意のパターンは、下にある酸化物を介してシリコン基板に伝導 され、その後、さらなる平滑化のために任意のファセット湿式プロセスを行うことができ る。ステップ9では、銀ナノ構造の蒸着とリフトオフによってリソグラフィプロセスを行 う。銀が記載されているが、金、白金、パラジウムなど他の金属を使用することもある。 あるいは、リソグラフィプロセスの代わりに、銀ナノ構造の堆積とリフトオフのために既 知の電子ビームリソグラフィを行うこともできる。

[0045]

図7は、前述のように、マイクロ流体チャネルを形成するためのプロセスフローの実施 例を示している。ステップ1は、サードパーティのサプライヤまたはメーカー内部のソー スからシリコン基板を提供することから始まる。ステップ2では、誘電体ハードマスクを 形成する。一実施形態では、ハードマスクは窒化物層を含むことができる。ステップ3で は、パターンとエッチングを行い、深さが約3ミクロンから約6ミクロンの浅いトレンチ を形成する。ステップ4で、ハードマスクが剥がされる。ステップ5では、トレンチの深 部を形成するために使用する深部エッチング用のフォトレジストを蒸着し、パターン化す る。ステップ6では深部シリコンエッチングを行う。深部トレンチの深さは約200ミク ロンである。ステップ7では、酸化のためにウェハを剥がして洗浄する。ステップ8では 、熱酸化プロセスを行い、約200ミクロンから約400ミクロンの厚さの酸化物層を形 成する。ステップ9では、導波管の露光とエッチングのために基板をパターン化し、ステ ップ10では、ウェットエッチングを行って、選択した導波管領域をオープン / 露光する 。任意のステップA)では、マイクロ流体チャネルへの粉砕副産物の侵入を制限するため に、材料を選択的にベント/フィーエッチングポートに堆積させることができ、その後、 材料は堆積させた材料の熱硬化を受ける。

[0046]

図8は、ドッキングステーションと検査カードの一実施形態の一般的なレイアウトを示 40 す。この概略図に見られるように、検査カードには、前述のようにナノ構造またはナノ粒 子によって修正されたマイクロ流体チャネルと導波管を含む光導波管検査構造が含まれる 。受動デバイスである検査カードには、検査サンプルをそこに受け取るための入力ポート と、マイクロ流体チャネルへの容易な流体の流れを可能にするためのベントポートが含ま れる。検査カードはパッシブであるため、使用後に破棄される場合がある。ドッキングス テーションの筐体に挿入すると、検査カードの導波管がドッキングステーションの光回路 と光学的に一致する。ドッキングステーションは、検査装置の能動要素で構成されており 滅菌後に使用することができる。例えば、後述のような光源と、干渉グラフを生成する 集積スペクトロメータを備え、集積スペクトロメータはフーリエ変換を受けてスペクトル を生成する。その後、スペクトルはコンパレータによって既知のスペクトルと比較され、 50

30

20

その後ドッキングステーションによって結果が出力される。 【 0 0 4 7 】

動作中、検査流体は入力ポートを介してマイクロ流体チャネルに配置される。次に、ドッキングステーションの安定化光源が、検査カードの導波管内をチャネルに沿って誘導される。チャネルと光導波管の領域が比較的長いため、導波管の周囲または間のエバネッセントに導かれた領域は、より多くのターゲット分析物と相互作用し、相互作用の合計によって増加したデータを得ることができ、検査の精度を高めることができる。センサ領域の端部で、光信号は、対象の分子または病原体に関連する電磁スペクトルの特定の部分にわたる光の特性を測定する集積スペクトロメータに入力される。これらのスペクトロメータは、共振器結合型検出器から後述の干渉計のような走査構造まで、幅広い集積構造の形態をとることができる。基準経路(reference arm)の固定長に対する一方の経路(one arm)の位相誘起伝搬変動は干渉パターン干渉グラフ(interferogram)を導入し、外部プロセッサに送信される。これは、高速フーリエ変換(FFT)によって、一意のピーク位置、幅、および形状から構成される一意の指紋のスペクトルに変換される。スペクトルはさらにコンパレータによって処理され、視覚信号や英数字の読み出しなどの検出可能な形式に送信できる最終的なデータセットが得られる。

【0048】

図9は、検査構造115を含むドッキングステーション105と検査カード110の内 部要素の概略的なプロック図を示す。図示された実施形態では、ドッキングステーション 105はハウジングを含み、概ね破線で示されている。ドッキングステーション105内 にはいくつかの要素が含まれている。図示された実施形態では、ドッキングステーション は、上述のような検査カードインターフェース905、レーザー、レーザドライバおよび センサのような光源、データの無線伝送のためにアンテナ910に接続された通信チップ 、DPFドライバおよびセンサ、データプロセッサ、ラマンスペクトロメータのような干 渉計に接続された干渉計ドライバおよびセンサ、および電源を含み、これらはすべてPC Bインターフェースおよびコントローラに動作可能に接続されている。本明細書および特 許請求の範囲で使用されているように、動作接続とは、光学的、電気的、または無線的に 、またはそれらの組み合わせによって、要素が接続され、データを取得および分析し、検 査結果を提供および/または送信するための動作ユニットを提供することを意味する。前 述のように、検査カードの導波管は、ドッキングステーションので表回路とも適 切に接続する。

【0049】

図9の実施形態では、フォトニック集積をマイクロ流体と積層造形法と組み合わせて、 コンパクトなラマン分光法ベースのシステムを迅速に実装し、ヒト集団に感染する病原体 の検出と同定を提供する。

【0050】

光集積回路のフーリエ変換(FT)スペクトロメータは、干渉によって時間領域の放射 線(radiation)を変調することで出力スペクトルを生成し、フーリエ変換を行う。位 相変調されたアームに沿って伝搬する信号と非位相変調されたアームとの間の干渉は、位 相の変化が振幅変化を引き起こすカプラに反射される。これを記録すると、変調されたア ーム内の駆動電圧または結果として生じる有効経路長の変動に対して、時間ベースの振幅 情報が記録され、これは干渉グラフ(interferogram)I(xeff)と呼ばれる。こ の干渉グラフは、干渉計の2つのアーム間の有効経路長の変化の関数として変調された放 射信号を表す。干渉光回路では、アナログ信号は光検出器で記録され、光検出器は符号化 されたラマンスペクトルの波長または波数情報を符号化する。次に、ラマンスペクトルを 回復するために、干渉グラフに対してフーリエ変換ルーチンが実行される。このシステム の利点はフォトニック集積回路、安定化光源である。一実施例では、共振空洞を使用して 、外部空洞に対して安定化され、ブラッグミラー(Bragg mirror)と位相チューナー で構成される初期利得分布を定義する。このアプローチにより、共振利得段の注入ロック 10

20

30

のために再注入される信号の位相と周波数の内容を制御することができる。 【0051】

上述のように、本開示の1つの実施形態はラマン分光法を使用するが、他のタイプのスペクトロメータを使用することもできる。ラマン分光法は、入射したレーザー光を試料から非弾性散乱し、その特徴的な分子振動のエネルギーによって周波数をシフトさせる手法である。ラマンスペクトルは、プローブされた物質の化学構造に関する高い情報量を提供し、この方法をウイルスと細菌の同定、違法薬物、医薬品および医薬品製造のモニタリング/検証、またはがん細胞の検出と同定のための理想的なツールにする。しかしながら、ラマンビームを対象物を含む表面上の一点に集中させる既知のプロセスとは異なり、本開示の実施形態は、導波管または導波管の長さの少なくとも一部に沿ってデータを収集する構造を提供し、データの量と精度を大幅に向上させる。

(16)

【0052】

実際には、検査流体はマイクロ流体チャネルに注入され、検査対象の分子が閉じ込められる。この閉じ込めにより、分子とプローブビームが最も重なり合うことが保証される。 さらに、マイクロ流体チャネルに配置された導波管の壁に沿って分子とナノ構造との緊密 で強力な相互作用を提供し、既知のデバイスおよびプロセスに対して強化されたラマンシ グナル強度を提供する。

【0053】

信号強度を改善するための表面増強ラマン分光法(SERS)の応用はラマン分光法の 改良である。細菌やウイルスなどの生体分子を同定するための非常に優れたアプローチと して実証されている。これは、特定の分子が、通常は銀、金、銅などの貴金属のように適 切な金属ナノ構造の近くに吸着または配置されたときに、その分子のラマン散乱シグナル が増強されることに基づいている。SERS法では、10<sup>14</sup>~10<sup>15</sup>という大きな増 強因子を得ることができ、最新の検査セットや検出パネルで使用される蛍光性有機色素や その他の試薬よりも大きなラマン散乱断面積をもたらすことが示されている。 【0054】

この開示の実施形態は、図9に一般的に示されているように、干渉計に接続された検出 器を使用してSERS相互作用からラマンスペクトルを検出する。このユニークなアプロ ーチは、スペクトロメータの一方の経路(in one arm of)における位相伝搬長変化の 関数として時間領域で変調された周波数依存情報を含む干渉グラフ(interferogram) を生成する。その後、システムはフーリエ変換を実行して、サンプル中に存在するウイル スの検出と識別に使用される詳細なラマンスペクトルを抽出する。

【0055】

図10は、マイケルソン干渉計などの干渉計の一実施形態と、ドッキングステーション 105に集積できる安定化光源を図式的に示したものであり、いずれも集積フォトニック 構成要素として示される。このアプローチでは、~660nmで動作するシェルフレーザ ーダイオード(shelf laser diodes)に接続されたファイバを使用することができるが 、コンパクトなスペクトロメータには、コンパクトなユニット内で必要なレベルの再現性 と集積を確保するために必要なスペクトル精度と波長スパンを提供するための、2つの構 成のいずれかの実装を含めることができる。フォトニック集積回路安定化光源は、一実施 形態では共振空洞であり、外部空洞に対して安定化される初期利得分布を定義するために 使用され、ブラッグミラーと位相チューナーで構成される。このアプローチにより、図1 0に示すように、共鳴利得段の注入ロックのために再注入される信号の位相と周波数の内 容を制御することができる。一般的に図9に示すように、既知のリソグラフィプロセスを 使用して、これらのフォトニック要素を形成し、ドッキングステーション105の実施形 態に集積することができる。

【 0 0 5 6 】

上記の実施形態の分析は、干渉計と接続した検出器を使用したSERS相互作用からの ラマン分光法に基づいている。この方法では、スペクトロメータの一方の経路の位相伝搬 長変化の関数として時間領域で変調された周波数依存情報を含む干渉グラフが生成される 10

30

。詳細なラマンスペクトルを抽出するフーリエ変換は、サンプル中に存在するウイルスの 検出と識別に使用される。

(17)

[0057]

光集積回路のフーリエ変換(FT)スペクトロメータは、干渉によって時間領域の放射 線(radiation)を変調することで出力スペクトルを生成し、フーリエ変換を行う。病 原体の検出と同定は、半導体の製造技術とパッケージング技術を活用して、6つの要素を 図に示したドッキングステーションのような比較的小さな領域に集積する能力によって保 証されている。これには、1)制御可能なラマンプローブを提供するための安定化された 狭帯域光源:2)導波管の外部を移動するモードエネルギーとラマン散乱のフォトニック 強化を提供する金属ナノ構造の制御されたオーバーラップを提供するエバネッセント接続 した低指数コントラスト導波管;3)病原体の特性評価のための制御された表面領域を提 供する導波管の間と上のナノ構造の形成;4)金属ナノ構造表面で対象の病原体を制御濃 縮 で き る 電 極 の 集 積 化 ; 5 ) 導 波 管 と 濃 縮 構 造 に 対 す る 試 料 体 積 を 閉 じ 込 め る た め の マ イ クロ流体構造の集積;6)小型フーリエ変換スペクトロメータの集積能力、が含まれる。 [0058]

迅速な検査製品を可能な限り迅速に利用できるようにするために、ここに開示された実 施形態は、検査のより単純なバージョンを可能な限り最短時間で提供することを可能にす る初期の受動的検査構造への道を開示している。

[0059]

検査ストリップ検出および同定システムのさまざまな実施形態には、ウイルス物質を含 20 む液滴をマイクロチャネルに閉じ込めることができ、プローブビームと対象物質との間の 相互作用断面積を改善することができるという独特の利点が含まれる。これにより、他の ど の ア プ ロ ー チ よ り も 感 度 が 何 桁 も 改 善 さ れ た シ ス テ ム が 提 供 さ れ る ; マ イ ク ロ チ ャ ネ ル の壁に沿って金属ナノ構造を適用し、複数の表面との強制的な相互作用を提供し、全体的 な相互作用の長さと蓄積された信号強度を増加させることから生じる信号感度の14から 15桁の増加;低コストの生成、接続、伝送、ラマンスペクトルの処理と検出、チャネル 内の局在化した金属ナノ構造の形成を支援するためのマイクロチャネル集積技術の適用と マイクロチャネルへのプローブビームの注入を制御するためのフォトニック集積回路と 支持素子との集積、マイクロチャネルを介して制御された方法でプローブをガイドし、プ ローブビームをフォトニック回路に再接続して処理とスペクトル抽出を行う;追加の人を 危険にさらすことなく、孤立したリアルタイムの単一点検査を可能にするために、センサ を使用可能な車両にパッケージングすること。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ 

ここで開示される実施形態は、

1 つの実施形態は、その中に形成された1または複数の相互接続された金属レベルを有 するプリント基板(PCB)検査カード基板と、PCBに配置され、1または複数の相互 接続された金属レベルに電気的に接続された検査構造とを備える検査装置を対象とする。 光 導 波 管 は 第 1 の シ リ コ ン 基 板 に 配 置 さ れ 、 マ イ ク ロ 流 体 チ ャ ネ ル は 第 2 の シ リ コ ン 基 板 に配置される。第1のシリコン基板に第2のシリコン基板が取り付けられる。マイクロ流 体チャネルは、光導波管の側面と最外面がマイクロ流体チャネル内に延びるように光導波 管上に配置され、マイクロ流体チャネルは光導波管の長さに沿って延び、その両端に流体 入力ポートと流体ベントポートを持つ。ナノ粒子は、マイクロ流体チャネル内に位置する 光導波路上または隣接して位置する。

[0061]

別の実施形態は、その中に形成された1または複数の相互接続された金属レベルを有す るプリント基板(PCB)検査カード基板と、PCBに配置され、1または複数の相互接 続された金属レベルに電気的に接続された検査構造と、第1のシリコン基板に配置される 光導波管と、第2のシリコン基板に配置され、第1のシリコン基板に取り付けられるマイ クロ流体チャネルと、を含むテスト装置を提供する。マイクロ流体チャネルは、光導波管 の側面と最外面がマイクロ流体チャネル内に延びるように光導波管上に配置され、マイク 10

30

10

ロ流体チャネルは光導波管の長さに沿って延び、その両端に流体入力ポートと流体ベント ポートを持つ。ナノ粒子は、マイクロ流体チャネル内に位置する光導波路上または隣接し て位置する。この実施形態は、その中で検査カードを受け入れるためのドッキングステー ションも含む。ドッキングステーションには、その中で検査カードを受け入れるように構 成された検査カードインターフェイスを持つハウジングがある。レーザーはハウジング内 に配置され、そこからの伝送を受信するために検査構造と光学的に位置合わせされる。干 渉計もハウジング内に配置され、検査構造に光学的に接続されてそこから光伝送を受信す る。データプロセッサと制御ボードがハウジング内に配置される。制御ボードは、これら の要素に動作的に接続されたレーザー、干渉計、およびデータプロセッサの動作を制御す るように構成される。

[0062]

要素1:検査構造は、検査カードの1つまたは複数の相互接続された金属レベルに接続 された、第1の基板内に形成された1つまたは複数の相互接続された金属層を含む。 【0063】

要素2:検査構造の1つまたは複数の相互接続された金属層は、第1の基板内に位置し 、光導波管に隣接する駆動電極を含む。

[0064]

要素3:ナノ粒子の濃度は、最外面の上よりも光導波路の側面の上の方が高い。

【0065】

要素4:光導波管はクラッド部分と非クラッド部分を有し、ナノ粒子は光導波管の非ク 20 ラッド部分に位置する。

[0066]

要素5:光導波管は側面と最外面に位置する窒化物層を含む。

[0067]

要素6:光導波管は窒化シリコンまたは酸窒化シリコンを含む。

【0068】

要素7:検査構造の光インターフェース端部は、V字型の溝内に位置する光ファイバを 備える。

【 0 0 6 9 】

要素 8 :検査カードがインターフェース端部を含み、検査カードのインターフェース端 30 部は、 V 字型溝ファイバマウントベース、フェルールマウントベース、およびそこから延 在する光フェルールを含み、光フェルールは検査構造の光ファイバに光学的に接続される

[0070]

要素9:ドッキングステーションは、ドッキングステーションからデータを無線伝送す るための電源と通信回路をさらに含む。

[0071]

要素10:通信回路がデータの無線送信のためのアンテナに接続される。

[0072]

要素11:さらに、レーザードライブとセンサ、DPFドライブとセンサ、および制御 40 ボードに動作可能に接続される干渉計ドライブとセンサを含む。

【 0 0 7 3 】

要素12:さらに光安定回路を含む。

[0074]

要素13:干渉計はマイケルソン干渉計である。

[0075]

要素14:さらに、検査カードをその中に受け入れ、検査カードをドッキングステーションに光学的および電気的に位置合わせするように構成されたバネ付クリップを含む。 【0076】

要素15:検査構造は、検査カードの1つまたは複数の相互接続された金属レベルに接 50

続 さ れ た 、 第 1 の 基 板 内 に 形 成 さ れ た 1 つ ま た は 複 数 の 相 互 接 続 さ れ た 金 属 層 を 含 む 。 【 0 0 7 7 】

要素16:検査構造の1つまたは複数の相互接続された金属層は、第1の基板内に位置し光導波路に隣接する駆動電極を含む。

[ 0 0 7 8 ]

要素17:ナノ粒子の濃度は、最外面の上よりも光導波管の側面の上の方が高い。 【0079】

要素18:光導波管にはクラッド部と非クラッド部を有し、ナノ粒子は光導波管の非ク ラッド部に位置する。

本発明は詳細に説明されているが、当業者は、本発明の精神および範囲を最も広範な形 10 態で逸脱することなく、ここで様々な変更、置換および変更を加えることができることを 理解すべきである。

【図面】

【図1A】



【図18】



【図1C】



【図 1 D】



40



【図1F】 <sup>120</sup> <sup>115</sup> <sup>115</sup> <sup>115</sup> <sup>115</sup> <sup>110</sup> <sup>120b</sup> <sup>110</sup> <sup>120b</sup> <sup>110</sup> <sup>120b</sup> <sup>110</sup> <sup>120b</sup> <sup>115</sup> <sup>115</sup>

【図2】



【図3A】



【図3B】









10

20

<u>315a</u>













# 【図4A】

【図4B】





30

10















10











(24)









## 【図 6 B】

【図8】



【図7】





30

20

10











(27)

【手続補正書】 【提出日】令和5年3月17日(2023.3.17) 【手続補正1】 【補正対象書類名】特許請求の範囲 【補正対象項目名】全文 【補正方法】変更 【補正の内容】 【特許請求の範囲】 【請求項1】 実装基板と、 10 第1の基板に形成された最上面および側面を有し、クラッド部および非クラッド部を有 する光導波管であって、前記第1の基板は半導体材料を含む、光導波管と、 <u>前記光導波管</u>の前記クラッド部に位置し、または前記クラッド部に隣接するナノ粒子<u>と、</u> 開口部を有し、前記第1の基板に位置するマイクロ流体チャネルであって、分析物が前 記開口部に堆積するとき、前記光導波路センサの前記クラッド部に接触する、マイクロ流 体チャネルと、 前<br />
記<br />
第<br />
1<br />
の<br />
基<br />
板<br />
に<br />
微<br />
吉<br />
に<br />
米<br />
志<br />
に<br />
米<br />
さ<br />
れ<br />
、<br />
前<br />
記<br />
ま<br />
装<br />
基<br />
板<br />
の<br /> 接続端部まで延在する、光ファイバを有する第2の基板と、を備える検査装置。 【請求項2】 前記検査構造は、前記第1の基板内に形成される1または複数の相互接続された金属層 20 であって、前記検査カードの前記1つまたは複数の相互接続された金属レベルに接続され た前記1または複数の相互接続された金属層を含み、前記検査構造の前記1または複数の 相互接続された金属層は、前記第1基板内に位置して前記光導波路に隣接する駆動電極を <u>含む、</u>請求項1に記載の検査装置。 【請求項3】 前 記 光 導 波 路 セン サ の 出 力 端 部 は 、 <u>フ ァ セ ッ ト 面</u> を 有 す る 、 請 求 項 1 に 記 載 の 検 査 装 置 【請求項4】 <u>前記ナノ粒子の濃度は、前記最上面の上よりも、前記光導波路の前記側面の上、または近</u> <u>傍において高い、請求項1に記載の検査装置。</u> 30 【請求項5】 <u>前記光導波路</u>は、窒化ケイ素または酸窒化ケイ素を備え<u>、窒化物層は前記光導波管の前記</u> 側面および前記最上面に位置する、請求項1に記載の検査装置。 【請求項6】 <u>前記第2の表面にV字溝を形成し、前記光導波路に光学的に接続された光ファイバが前記</u> <u>V字溝に位置する、</u>請求項1に記載の検査装置。 【請求項7】 第1の基板に形成された最上面および側面を有し、<u>クラッド部および非クラッド部を有</u> し、入力端部と出力端部とを有する光導波管であって、前記出力端部はファセット面を有 <u>し、</u>前記第1の基板は半導体材料を含む、<u>光導波管</u>と、 40 <u>前記光導波管の前記クラッド部</u>に位置し、または<u>前記クラッド部に隣接する</u>ナノ粒子と、 開 口 部 を 有 し 、 前 記 第 1 の 基 板 に 位 置 す る マ イ ク ロ 流 体 チ ャ ネ ル で あ っ て 、 分 析 物 が 前 記開口部に堆積するとき、前記光導波路センサの前記クラッド部に接触する、マイクロ流 体チャネルと、 <u>前記第1の基板に隣接して位置し、前記光導波路に</u>光学的に接続され、<u>前記実装基板</u>の接 続端部まで延在する、光ファイバを有する第2の基板と、 を備える検査カード基板と、 前記検査カードを受け入れるように構成されたドッキングポートを有するハウジングと

前記ハウジング内に位置し、前記検査構造と光学的に位置合わせされ、そこから伝送を 50

受信するレーザーと、

前記ハウジング内に位置し、前記検査構造に光学的に接続可能で、そこから光伝送を受信する集積スペクトロメータと、

前記ハウジング内に位置するデータプロセッサおよび制御ボードであって、前記制御ボ ードは前記レーザーと、干渉計と、前記データプロセッサとの動作を制御するように構成 された前記制御ボードと、

を備える、前記検査カード基板の前記接続端部を受け入れるためのドッキングステーションと、

を備える検査装置。

【請求項8】

10

20

30

40

前記ドッキングステーションは、電源と、前記ドッキングステーションからのデータの 無線伝送のための通信回路と、をさらに備え、前記通信回路は前記データの無線伝送のた めのアンテナに接続される、請求項<u>7</u>に記載の検査装置。

【請求項9】

前記制御ボードに動作可能に接続される、レーザー駆動装置およびセンサと、DPF駆動装置およびセンサと、干渉計駆動装置およびセンサと、をさらに備える、請求項<u>8</u>に記載の検査装置。

【請求項10】

<u>前記ナノ粒子の濃度は、前記最上面の上よりも、前記光導波路の前記側面の上、または近</u> <u>傍において高い、請求項7に記載の検査装置。</u>

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0001]

「関連出願の相互参照]

本出願は、「DOCK STATION WITH WAVEGUIDE ENHANCED ANALYTE DET ECTION STRIP」と題する2020年3月24日に出願された米国特許出願第<u>62/994</u> <u>,200</u>号、「ENHANCED WAVEGUIDE WITH MICROFLUIDIC PUMP」と題する2 020年7月25日に出願された米国特許出願第63/056,580号、および「DOCKING STATION AND WAVEGUIDE WITH ENHANCED ANALYTE DETECTION STRIP AND OPTICAL AND ELECTRICAL ALIGNMENT SYSTEM」と題する2020年1 0月23日に提出された米国特許出願第63/104,636号の利益を主張するものであり、 一般に本発明に割り当てられ、参照により本発明に組み込まれている。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0012]

検査カード110/検査構造115とドッキングステーション105との間の光学およ び電気回路の適切な機械的位置合わせは、いくつかの方法で達成することができる。例え ば、ある実施形態では、図1Bおよび図1Bの一般的な断面図である図1Cに見られるよ うに、検査カード110はプリント基板(PCB)であり、PCBの層間に形成された1 つ以上の金属レベル110aを含む。図1Cに概略的に示すように、1つ以上の金属レベ ル110aは、検査構造115の1つ以上の金属レベル115aに電気的に接続されてい る。既知のプロセスを使用して設計および製造することができる1つ以上の金属レベル1 10a、115aは、検査カード110のインターフェース端110cで検査構造115 を<u>電気リード接点</u>110bに電気的に接続する。この実施形態は、検査流体をその中で受

け取ることができる流体入力ポート115 bを備えた検査構造115を含む。前述のよう に、 <u>電気リード接点</u>110 b は、検査カード110 がドッキングステーション105 に挿 入されたときに、検査カード110 とドッキングステーション105 との間の電気的接続 を提供する。さらに、一実施形態では、検査構造115 は、検査構造115の基板に形成 された V 字型の溝に配置することができる光ファイバー115 d を含む光インターフェー ス端部115 c を含む。光ファイバ115 d は、検査構造115 とドッキングステーショ ン105 内の光学部品との間の光接続を提供し、 <u>電気リード接点</u>110 b は、検査カード 110 とドッキングステーション105 との間の電気接続を提供する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

図1Dは、検査カード110および検査構造115の別の実施形態の斜視図を示してい る。この実施形態では、検査カード110は、検査カード110がドッキングステーショ ン105に適切に挿入されたときに、ドッキングステーション105の電気回路(図1A )への電気接続を提供する電気リード接点110bを含む。特定の実施形態では、静電短 絡の発生を防ぐために、電気リード接点110bに接地リード110b(2)を含めるこ とができる。検査構造115は、光フェルール(ferrule)<u>キャップ</u>110eがマウント された V 字型の溝型のファイバマウントベース110dまで延びる2つの V 字型の溝型の 光ファイバ115d(dual V-Groove optical fibers)を含む。光フェルール<u>キャッ</u> <u> プ</u>ベース110eは、間隔を空けて配置され、<u>光ファイバ115dが延びる光フェルール</u> <u>1 1 0 f を含む。光ファイバ 1 1 5 d は、</u>検査構造 1 1 5 の導波管 2 0 5 に光学的に接続 され<u>る</u>。光ファイバ115cとフェルール110fは2つしか示されていないが、他の実 施形態では示されている数以上の光ファイバと光フェルールを含むことができる。この図 には示されていないが、検査カード115内の前述の金属レベルは、検査構造115から 電気リード接点110bまで延在し、検査カード110と図1Aのドッキングステーショ ン105との間の電気的接続を提供する。検査カード110をドッキングステーションに 挿入すると、検査構造115の光学リードおよび電気リードは、図1Aのドッキングステ ーション105の光学および電気回路に位置合わせされるか、接続される。 【手続補正5】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

**[**0014]

上記で説明した実施形態では、既知のリフロープロセスを使用して検査<u>構造</u>115を検 査カード110に取り付け、検査カード110の金属<u>レベル</u>110aを検査<u>構造</u>115の 金属<u>レベル</u>115aと電気的に接触させることができる。

【 手 続 補 正 6 】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

図1 E は、図1 A のドッキングステーション1 0 5 が、検査構造1 1 5 の 2 つの V 字型 の溝型の光ファイバ<u>1 1 5 d</u>を、<u>導波管</u>1 0 5 b およびドッキングステーション1 0 5 の 電気回路(図示せず)と適切な光学的および電気的位置合わせに保持するために使用され る、スプリングバイアスクリップ装置1 0 5 a を含む一実施形態の部分的な上面図を示し 20

ている。この実施形態では、検査カード110上に検査構造115を高精度に配置して位 置合わせの複雑さを軽減し、 × 軸と z 軸の導波管端の位置精度を 5 ミクロン未満にするこ とができる。スプリングバイアスクリップ装置105aは、検査構造115と検査カード 1 1 0 の 端 を ド ッ キ ン グ ス テ ー シ ョ ン 1 0 5 と の 光 学 的 お よ び 電 気 的 接 続 に 導 く だ け で な く、 - 度 接 続 が 行 わ れ る と 、 ド ッ キ ン グ ス テ ー シ ョ ン <u>1 0 5</u> に 対 し て 相 対 的 に 検 査 カ ー ド 1 1 0 を保持する。さらに別の実施形態では、導波管位置合わせの正確な基準を提供する ために、滑らかな表面と既知の厚さを実現するために、検査カードにアルミナを使用する ことができる。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0016]

前述のように、検査構造115には流体サンプルまたは入力ポート115bがある。し かしながら、場合によっては、サンプルを提供する者を検査を実施する者からさらに隔離 することが望ましい場合もある。このような場合には、拡張検査ストリップ構成を利用す ることができる。図1Fは、検査構造115がフレキシブルストリップ120a内に配置 された光学的および電気的経路(図示せず)を持つフレキシブルサンプリングアダプタ1 20に接続可能な一実施形態を示している。フレキシブル<u>サンプリングアダプタ</u>120の ー端には、対応する光学 V 溝 1 1 5 b と、検査構造 1 1 5 に接続する電気接点があり、反 対側の端には、 V 字型の溝 1 2 0 b と、検査カード 1 1 0 に接続する電気接点があり、こ れらは、上述の実施形態を介してドッキングステーションに挿入することができる。距離 規制が必要な場合、フレキシブルサンプリングアダプタ120は、検査サンプルを収集す る際により多くの距離の分離を可能にする。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0017]

|操作の一実施形態では、ドッキングステーション105内のフォトニック測定インフラ ストラクチャと検査カード110上の検査構造115との間の光学的位置合わせを確保す るためのキャリブレーションサイクルが行われるドッキングステーション105に検査カ ード110が配置される。このキャリブレーションが完了すると、緑色のLED、または その他のキューによって、検査カード110のサンプルの準備ができていることが示され る。分析物の単一液滴を流体入力またはサンプルポート<u>115</u>に置く。必要なサンプル 体積は0.1nLから10nLの間である。検査構造115のマイクロ流体チャネル内の 伝搬は、チャネル内の抵抗変化によって測定される。サンプルを検出した後、目標長を伝 播するとして、誘電泳動(dielectrophoretic)のサイクルを可変周波数で行い、ラマ ンスペクトル測定を行うことで、上記のように必要に応じて過剰な生体分子干渉を差し引 く機構を提供することで、最高レベルの精度を確保する。

40

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正の内容】

#### [0018]

図 2 は、図 1 に一般的に示されているように、検査カード 1 1 0 の検査構造 1 1 5 の一 実 施 形 態 の 部 分 的 な 断 面 図 を 示 す 。 こ の 実 施 形 態 で は 、 検 査 構 造 1 1 5 は 半 導 体 基 板 2 1 50

10

20

30

0 上に配置された導波管205を含む。半導体基板210は、シリコン基板上の二酸化シ リコンを備え、二酸化シリコン層内に形成された1つ以上の相互接続された金属レベル2 10a、210bを含む。既知のリソグラフィおよび蒸着プロセスを使用して、検査構造 1 1 5 を作成することができる。一実施形態では、半導体基板 2 1 0 内の金属レベル 2 1 0 a、2 1 0 bの1 つは、導波管2 0 5 に垂直な電磁場を形成するために使用できる誘電 体泳動フィルタ(DPF)を形成するために使用できる2つの電極の1つである駆動電極 2 1 5 を含み得る。 <u>DPFはDPFドライバによって駆動される。</u>ただし、他の実施形態 では、駆動電極215はオプションであり、したがって、存在しない場合もある。一実施 形態では、<br />
導波管<br />
205は<br />
SiN2、<br />
Si3N3、<br />
SiONなどの<br />
窒化シリコン材料を含 み、既知のリソグラフィおよび蒸着プロセスを使用して蒸着およびエッチングすることが できる。窒化シリコンを例として挙げたが、ヒ化ガリウム、ヒ化アルミニウムガリウム、 シリコン、酸化アルミニウム、オキシ窒化シリコン、ドープニ酸化シリコン(チタン、リ チウム、リン、ホウ素など)、またはそれらの組み合わせなどの他のタイプの導波管を使 用してもよく、これらも本開示の範囲内である。基板210、金属レベル210a、21 0 b、および導波管 2 0 5 は、以下で説明する他の要素とともに、独自の光学検査回路を 形成する。

【手続補正10】 【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

半導体基板210の導波管205がある側に、第2のシリコン基板225が接合されて いる。第2シリコン基板225にはマイクロ流体チャネル230が形成される。マイクロ 流体チャネル230は、一般的に示されているように、導波管205の側面205aと<u>外</u> 面205bがマイクロ流体チャネル230内に延びるように、導波管205をカプセル化 する。マイクロ流体チャネル230は、検査流体または分析物が配置されるチャネルを提 供する。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 2 】

駆動電極215が存在するこれらの実施形態では、第2の基板225は駆動電極235を 含む。駆動電極215と235を使用して、病原体などの対象の分子のナノ構造表面への 制御された遷移を促進するための追加の電場を生成することができる。図の実施形態で見 られるように、一般的に示されるように、駆動電極215は<u>半導体</u>基板210内に位置し 、導波管205に隣接し、駆動電極235は<u>第2の</u>シリコン基板225上に位置し、マイ クロ流体<u>チャネル</u>230内にある。駆動電極235は、別の実施形態で示されているよう に金属ストリップであってもよいし、n型基板またはシリコン表面を大量に注入して形成 してもよい。駆動電極215および235を使用して、マイクロ流体チャネル230内で 誘電泳動(DEP)力を発生させるための高周波(3-5MHz)電圧を電極に印加し、 対象の分析物を測定表面に駆動することができる。

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

図3Fは、既知の堆積プロセスを使用した、酸化シリコン層340の堆積後の図3Eの 中間デバイスを示している。酸化シリコン層340の厚さは様々であるが、一実施形態で は厚さは約2ミクロンであり得る。また、酸化シリコン層340は、後述するように導波 管315aの少なくとも一部に対してクラッド層として機能する。

【 手 続 補 正 1 3 】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0034】

10

図3 I は、図3 H に 見られるように、露出した 導波管3 1 5 a 上にナノ構造3 5 5 が形 成された後の中間構造を示している。いくつかの実施形態では、ナノ構造3 5 5 は、約1 4 0 n m から3 0 0 n m ピッチで約 7 0 n m から約 1 0 0 n m の範囲の直径を持つことが できる。ただし、デバイスのパフォーマンスを最適化するために、他の範囲やピッチを使 用することもできる。ナノ構造を形成するために異なる堆積プロセスを使用することがで きる。例えば、一実施形態では、ナノ構造3 5 5 は、インクジェット堆積プロセスを使用 して堆積させることができる。別の実施形態では、ナノ構造3 5 5 は、深紫外線(D U V )フォトリソグラフィまたは金属蒸着リフトオフを伴う電子ビームリソグラフィを使用し て、用いられることができる。このような実施形態では、リフトオフ構造の厚さは、平均 直径に応じて、約 4 0 n m から約 8 0 n m の範囲である。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0036]

図4Aは、一実施形態では、既知のP型ドーパントがドープされた200mmのシリコ ンウエハであり得るウエハ405を示し、その濃度と拡散深度は最適化された設計要件に よって異なり得る。酸化成長や堆積プロセスなどの既知のプロセスを使用してシリコンウ エハ405上に酸化物410を形成する。酸化層410の厚さは波打つことがある。例え ば、ウェットエッチング条件では、厚さは約100nmまたは30nmから50nmであ り得る。窒化シリコン層415は酸化物層410の上に配置され、特定の実施形態では、 その厚さは約300nmであり得る。窒化シリコン層415は浅いトレンチエッチングの ハードマスクの特徴である。酸化物層410は、その後のステップで窒化ケイ素415層 の孤立除去を提供する。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

図4Hに示す中間構造のクリーニングに続いて、浅いトレンチ430と深いトレンチ<u>4</u> <u>40</u>が形成されたシリコンウエハ405を反転してフォトニック基板に接合し、図2に示 す一般的な構造となる。

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	·	International appli	cation No.
			PCT/US 21/2299	6
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER 01N 15/06, B01L 3/00, H05K 1/02, H05K 3/2	28 (2021.01)		
CPC - G 3/	01N 15/06, G01N 2015/0046, G01N 2015/06 502715, G01N 2021/058	693, B01L 2200/12	2, B01L 2300/06	645, B01L
0,				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification ar	nd IPC	
B. FIELD	S SEARCHED			
Minimum doo See Search H	cumentation searched (classification system followed by clistory document	classification symbols)		
Documentatic See Search H	on searched other than minimum documentation to the ext listory document	ent that such document	s are included in the	fields searched
Electronic dat See Search H	a base consulted during the international search (name of listory document	data base and, where p	macticable, search ter	ms used)
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appro	opriate, of the relevant	passages	Relevant to claim No.
Y	US 2003/0096081 A1 (LAVALLEE et al.) 22 May 2003 [0034], [0042], [0047], [0050]-[0053], [0056], [0056], [00	(22.05.2003), para [00 067]	010], [0011], [0033],	1-3, 5, 7-12, 14, 15, 17, 18, 20
n				4, 6, 13, 16, 19
Y	US 2019/0170631 A1 (SENSOR KINESIS CORPORATION) 06 June 2019 (06.06.2019), para 1-3, 5, 7-12, 14, 15 (0030), [0259], [0297], [0304]		1-3, 5, 7-12, 14, 15, 17, 18, 20	
~				4, 6, 13, 16, 19
Y	US 2013/0170782 A1 (EVANS et al.) 04 July 2013 (04	.07.2013), para (0027),	, [0072], [0080}	3, 18
Y	US 2020/0072828 A1 (NATIONAL CHUNG CHENG U (05.03.2020), para [0006], [0051]	NIVERSITY) 05 March	2020	5, 20
Y	US 2019/0025505 A1 (AMS AG) 24 January 2019 (24.	01.2019), para [0005],	[0097]	7
Y	US 2008/0267564 A1 (HAN et al.) 30 October 2008 (3)	0.10.2006), para (0081	]-[0082]	8,9
Y 	WO 2019/018870 A1 (TECHNISCHE UNIVERSITAT V para [0018], [0032], [0055], [0062], [0067]	170 A1 (TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN) 31 January 2019 (31.01.2019), 10-12, 14, 15, 17, 18, 20 032], [0055], [0062], [0067] 13, 16, 19		
Y	US 2016/0334866 A9 (MAZED et al.) 17 November 20	16 (17.11.2016), para	[0872], [1060]	11, 12
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent	family annex.	
* Special "A" docume	categories of cited documents: It defining the general state of the art which is not considered perior law procession of the state of	"T" later document pu date and not in c the principle or th	ublished after the inter onflict with the applic heory underlying the i	national filing date or priority ation but cited to understand nvention
"D" docume "E" earlier a	nt cited by the applicant in the international application pplication or patent but published on or after the international	"X" document of par considered novel when the docume	ticular relevance; the or cannot be considere ant is taken alone	claimed invention cannot be ed to involve an inventive step
"L" docume is cited special t	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which to establish the publication date of another citation or other eason (as specified)	"Y" document of pa be considered to combined with or	rticular relevance; th involve an inventive ne or more other such (	e claimed invention cannot step when the document is documents, such combination
"O" docume "P" docume the prior	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	being obvious to "&" document memb	a person skilled in the er of the same patent :	e art family
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of th	e international sear	ch report
28 May 2021		JUN	082021	
Name and m	ailing address of the ISA/US	Authorized officer	Lee Young	
P.O. Box 145	10, Alexandria, Virginia 22313-1450	Telephone No. PCT	Heipdesk: 571-27	/2-4300
Pacsimile N	3. 37 1-273-6300	Telephone Hu Of		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2019)

10

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International application No.			
		PCT/US 21/229	PCT/US 21/22996		
C (Continuation).	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		• · · ·		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.		
Y US: [002	2017/0115110 A1 (UNIVERSITY OF WASHINGTON) 27 April 2017 (27 20], [0028]	.04.2017), para	14, 15		
A US:	2011/0166512 A1 (BOTH et al.) 07 July 2011 (07.07.2011), para (0077	], [0087]	16		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 2019)

フロントページの続き

- (32)優先日 令和2年7月25日(2020.7.25)
- (33)優先権主張国・地域又は機関

米国(US)

- (81)指定国・地域 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT, NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD ,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,D J,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,IT,JO,JP,KE,KG,KH, KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO, NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,T T,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,WS,ZA,ZM,ZW
- (72)発明者 キャロザーズ,ダニエル

### アメリカ合衆国 75002 テキサス ,ルーカス ,ロック リッジ ロード 1300

- F ターム(参考) 2G043 AA01 AA04 BA16 BA17 CA04 DA05 EA03 FA05 HA02 HA05
  - JA01
  - 2G058 CC05 CC14 EB19 GA06